

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-08

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	红杉资本、汇添富基金、平安基金、兴业基金、东吴基金、华富基金、中海基金、深圳纽福斯投资、深圳火神投资、Kontiki Capital、友邦人寿、人保资产、招商信诺资管、长城财富保险资管、天虫资本、趣时资产、惠升基金、深圳前海行健资本、大家资管、瑞达基金、洪运瑞恒基金、创金合信基金、西部证券、中信证券、天风证券、长城证券、民生证券、国海证券、东吴证券、国信证券、中信建投证券、浙商证券、财通证券、招商证券、方正证券、华福证券、中泰证券、华创证券
时间	2023年8月30日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵，杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了民德电子 2023 年上半年公司业绩情况，以及各业务板块进展情况，随后对投资者关心的问题进行了解答。</p> <p><b>一、民德电子 2023 年上半年业绩情况介绍</b></p> <p><b>整体情况：</b></p> <p>1、公司条码业务上半年的营收及利润保持增长，海外业务增长迅速；功率半导体业务，受半导体市场需求低迷，以及公司功率半导体产业链部分环节企业（广芯微、芯微泰克）仍处于建设期、仅有费用支出的影响，公司上半年半导体业务营收及利润有所下滑。</p> <p>2、公司 smart IDM 生态圈各环节的建设正常推进中，今年各环节将全部投产，公司护城河进一步夯实，将为公司后续在功率半导体产业的发展奠定稳定的供应链基础。</p>

### 财务数据方面：

1、2023 年上半年，公司主营业务为条码识别、半导体设计和分销业务，实现营收 1.83 亿元，较上年同期减少 2,095 万元，同比下降 10.26%。其中信息识别及自动化产品业务保持稳健发展，销售收入同比增加 1,464 万元；半导体设计公司广微集成，受晶圆代工厂迁移影响，上半年营收同比减少 1,179 万元；电子元器件分销公司泰博迅睿，上半年营收同比减少 2,380 万元。

2、公司上半年实现归属上市公司股东净利润 1,368.06 万元，较上年同期减少 1,849.61 万元，同比下降 57.48%，其中联营企业晶睿电子，受半导体行业及硅片市场需求低迷影响，上市公司获得的投资收益较去年同期减少 772 万元，广微集成上半年归属于上市公司股东的净利润同比减少 385 万元，泰博迅睿上半年净利润同比减少 456 万元。

3、公司上半年经营活动产生的现金流量净额 3,754 万元，同比下降了 17.52%，降幅明显低于净利润降幅，且是归母净利润的接近 3 倍，公司依然保持非常良好的正向现金流状态。

4、产品毛利率方面，信息识别及自动化产品毛利率 44.83%，变化不大，信息识别及自动化产品保持较好毛利率水平。功率半导体产品毛利率 11.88%，广微集成的产品毛利率降幅比较明显，一方面是因为广微集成目前销售的主打产品 MOS 场效应二极管（MFER），是去年为应对 6 英寸晶圆代工产能迁移而积极备货的产品，当时代工价格和原材料成本都处于高位，导致今年上半年的产品毛利率降低；另一方面，广微集成今年开始批量销售的 SGT-MOSFET，前期量比较小，毛利率低，综合导致广微集成产品毛利率降幅较大；后续随着广芯微电子量产，以及 SGT 产品逐步上量，产品的代工成本有望有较大下降，同时广微集成后续也会陆续推出成品，功率半导体产品的毛利率将逐步提升。

## 二、各业务板块近期进展

### （一）功率半导体业务

功率半导体业务包括公司控股的功率半导体设计公司广微集成，参股的晶圆代工厂广芯微电子、超薄背道代工厂芯微泰克、晶圆原材料企业晶睿电子等。

#### 1、功率半导体设计公司广微集成

广微集成的 6 英寸晶圆代工产能四季度将切换至浙江丽水的广芯微电子，目前无新增产能，上半年 MFER 产品主要依靠去年备货的产品进行销售，后续随着广芯微电子产能陆续释放，广微集成业绩有望迎来持续增长。同时，广微集成在 12 英寸晶圆代工厂开

发的 SGT-MOSFET，在今年也开始逐步上量，60V、80V、100V 系列产品已量产并开始批量销售，其中，60V 已经完成产品系列化，80V、100V 正在产品系列化过程中。

## **2、晶圆代工厂广芯微电子**

广芯微电子今年 5 月 19 日投产通线，目前处于研发流片阶段。今年广芯微主要任务是和设计公司客户一同开发出尽可能多的产品，重点是 MFER 产品和 900/1200V 特高压 MOSFET 产品。目前正在对 MFER 工艺进行校准，预计 9 月底可以将样品正式送给客户验证，今年计划开发出 MFER 的 80-120V 全系列产品；同时，今年也将完成 900/1200V 特高压 MOSFET 平台产品的量产，后续广芯微电子将根据建设进度以及市场情况，推出更多新的产品。产能方面，预计今年年底实现 3,000-5,000 片/月 6 英寸晶圆加工产能，明年底实现 3 万片/月 6 英寸晶圆加工产能。

## **3、超薄背道代工厂芯微泰克**

芯微泰克 8 月份获得丽水政府基金 5,000 万增资，项目建设资金进一步充实，项目建设正按照计划正常推进中，目前在进行净化厂房建设和机电安装工程，背道加工工艺设备采购已基本完成，预计 9 月下旬开始设备进场，10 月份开始安装调试，11 月份进行试生产及通线工作，12 月份开始量产。目前芯微泰克已有十多家在谈客户，预计今年年底将形成小批量代工销售，大批量销售预计 2024 年二季度开始。

## **4、晶圆原材料公司晶睿电子**

今年上半年，硅片行业市场低迷，晶睿电子上半年销售收入略微下滑，因库存原材料价格高、销售价格降低，上半年晶睿电子净利润降幅明显。但二季度末市场形势已有所好转，高价库存产品基本消化完成，公司原材料成本明显下降，产量逐步提升。同时，晶睿电子也开拓了几家战略大客户，加上二期项目和碳化硅外延片项目均按计划正常推进中，这些都将成为晶睿电子的增长提供支持。

### **(二) 半导体分销业务**

出于优化现金流考虑，泰博迅睿对电子元器件分销客户进行了优化调整，同时由于动力和储能电池下游端市场低迷，导致泰博迅睿上半年营收和利润有所下降；后续泰博迅睿将把业务重点放在服务优质客户方面，投入更多资源在新能源、汽车电子等领域。未来对泰博迅睿的目标是保持稳定的经营规模和健康的财务结构。

### **(三) 条码识别业务**

条码识别业务是公司的传统主业，自上市以来一直保持较高的毛利率和良好的经营

净现金流。今年上半年，条码业务保持稳健增长，销售收入同比增长 18.97%，特别是海外销售同比增长 91.77%，中国品牌性价比优势已凸显出来，获得海外客户高度认可。公司也在不断升级条码产品，近期也推出首款带 AI 功能的平台产品，产品将极大提升在复杂场景下条码识别速度和精度，有助于公司开拓更多的中高端市场。未来条码识别业务将一直作为公司的基础业务之一，为公司发展提供稳定的经营现金流。

### 三、问答交流

#### 1、广芯微电子项目建设进度如何，今年将推出哪些产品，产能有多少？

答：广芯微电子首先量产的产品是广微集成最成熟的 MFER，目前产线正在对 MFER 工艺进行校准，处于工程批流片阶段，预计 9 月底可以将样品正式送给客户验证，四季度开始量产；同时，今年广芯微电子还将量产 900/1200V 特高压 MOSFET，产线各项调试工作在按计划推进中。广芯微电子作为一家新建的晶圆代工厂，在从 0 到 1 的过程中会碰到很多难以预计的困难和问题，但项目整体按照计划推进，产线已完成投产通线，目前在进行产品量产的调试工作，预计到今年年底广芯微电子可达到 3000-5000 片/月的产能；后续产品从 1 到 10 的扩张进度将会更快，明年广芯微电子也将根据市场情况逐步提升产能，并推出更多的新产品。

#### 2、广芯微电子的碳化硅产品开发的进展情况如何？

答：今年广芯微电子将重点保障 MFER 和特高压 MOS 的量产工作，碳化硅产品将会和设计公司一起做好前期准备工作，具体进度将根据项目调试进度和市场情况来推进。

#### 3、广微集成产品毛利率降低很多，原因是什么？后续是否会好转，合理的毛利率大概在什么水平？

答：广微集成今年上半年主要销售产品为 6 英寸的 MFER 和 12 英寸的 SGT-MOSFET。MFER 产品是去年广微集成为应对 6 英寸晶圆代工产能迁移、维系大客户销售而积极备货，当时的代工价格和原材料价格都处于高位，所以 MFER 产品上半年的毛利率较前两年的 25-30%水平有所下降；SGT-MOSFET 为今年开始批量销售的新产品，毛利率不到 10%。因此，今年上半年广微集成产品的毛利率有较大下降。

广微集成的 MFER 主要是以半成品的晶圆片裸片进行销售，去年之前的毛利率维持在 25-30%，后续随着在广芯微电子代工产品的量产，MFER 代工价格和成本有望降低，同时，广微集成未来将以销售成品为主，产品毛利有望进一步提升。SGT-MOSFET 产品因前期产量比较小，代工价格较高，随着产能增加，今年代工厂已下调代工价格，后续随着

产能不断提升，代工价格有望继续降低，同时随着 SGT-MOSFET 产品系列不断完善，单位成本持续下降，以及销售价格的提升，产品毛利率将会有显著增加。

**4、芯微泰克项目进展情况如何，产能有多少？**

答：芯微泰克项目目前在净化厂房建设和机电工程阶段，预计 9 月下旬开始设备搬入，10 月份进行设备安装调试，11 月份开始试生产及通线，12 月份投产。芯微泰克今年开发的主要工艺包括：常规功率器件的薄片背道工艺、6/8 英寸 IGBT 背道工艺、功率器件的测试工艺等；预计到今年年底形成常规功率器件背面工艺产能 3 万片/月、IGBT 背道工艺产能 1 万片/月。因客户的产品验证周期有所不同，芯微泰克今年底预计会有小批量的代工销售，大批量销售预计 2024 年二季度开始。

**5、国外对中国半导体设备限制越来越严苛，对公司后续设备购买和扩产是否有影响？**

答：广芯微电子目前从海外进口的整线设备已全部到位，设计产能 6 英寸硅基产品为 7 万片/月，碳化硅产品 600 片/月，而且在整线设备中有部分设备是备用机，作为后续产线维护或替换用。广芯微电子项目主要面向功率半导体领域“成熟制程、特色工艺”的产品加工，设备还是可以通过多种海外渠道进行采购，国外限制措施可能会增加获取设备的资金成本和时间成本；同时，后续产线的产能提升，也将采用更多的国产设备。因此，国外对半导体设备的限制，对公司后续设备购买和扩产影响有限。

**6、泰博迅睿的商誉是否还会减值？**

答：根据企业会计准则相关要求和公司实际情况，公司每年年终将会对企业并购过程中包含商誉的资产组进行减值测试，届时公司聘请独立、专业的第三方资产评估机构对泰博迅睿相关商誉资产组的可收回金额进行资产评估和减值测试，并根据测试结果确定是否计提减值。泰博迅睿近几年商誉已累计计提减值 6,748 万元，目前账面价值为 4,008 万元，同时随着公司规模的不不断扩大，公司的商誉减值风险在可控范围内。

**7、条码业务上半年在海外销售增长很快，原因是什么，后续是否能持续？**

答：海外市场方面，公司的条码识别设备经过近几年在实际使用过程中的验证，产品的性价比得到客户的高度认可，因此市场渗透率不断提升，相对于国际品牌的条码识别产品，在实现同样功能的情况下，中国品牌设备有非常明显的价格优势，更受客户青睐。海外市场空间巨大，公司条码识别设备市场占有率并不高，后续公司也将加大海外市场开拓力度，抢占更多的市场。

	<p><b>8、条码识别设备新开发带 AI 功能的平台产品与以前的产品比有何优势，主要应用场景有哪些？</b></p> <p>答：公司开发带 AI 功能的条码识别设备，主要针对复杂场景下条码识别，通过大量数据训练，可对传统条码识别算法难以识别的污损、反光、褶皱等条码，有更快更准确的识别，比如在工业自动化产线、新能源汽车及电池、电子器件，以及商超零售领域的一些复杂条码场景，带 AI 功能的条码识别设备会有更高的精度与准确度，应用领域更加广泛。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-08-30